



(JAC Career) DSSBU SPEシステム部／エッチング装置プロセス開発エンジニア

大手半導体製造装置メーカーでの募集です。商品企画・商品開発（技術系）のご経験...

募集職種

人材紹介会社

株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント

採用企業名

大手半導体製造装置メーカー

求人ID

1500482

業種

機械

雇用形態

正社員

勤務地

その他東京

給与

500万円～1100万円

勤務時間

09:00～17:30

休日・休暇

【有給休暇】初年度 最大12日 1か月目から（入社時期により付与日数は変動します）【休日】完全週休二日制 土 日 祝日 GW...

更新日

2024年12月19日 15:00

応募必要条件

キャリアレベル

中途経験者レベル

英語レベル

ビジネス会話レベル

日本語レベル

ネイティブ

最終学歴

高等学校卒

現在のビザ

日本での就労許可が必要です

募集要項

【求人No NJB2259154】

【業務内容】

- 半導体向けエッチング装置のプロセスエンジニアまたはマネジメント業務を行います。
- ・半導体前工程、特にエッチングプロセスを理解した上で、所属営業部の戦略を理解し、顧客のプロセス要求や目的を把握して自社のエッチング装置のプロセス開発および条件出しを行います。
 - ・顧客向けのプロセス報告書を作成し、直接顧客へ報告を上司や営業と一緒にいきます。
 - ・顧客サイトでの条件だしサポートが必要な場合は、現地に赴いて顧客CRで作業する事もあります。
 - ・必要に応じて上長・先輩社員の指示・指導・アドバイスを受けながら、非定型業務を担当します。

スキル・資格

【必須】

半導体およびフラットパネルのエッチング装置に関するプロセス技術の実務経験が2年以上ある方。

【尚可】

半導体製造装置の海外営業またはマーケティング経験のある方。

会社説明

ご紹介時にご案内いたします